

6/28

寬能帶功率半導體測試與3DIC應用(3)

近年來5G通訊、電動車、儲能、電池、工控設備等應用大增，寬能帶半導體(WBG)材料，如碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)，為產業帶來更高效能、更輕巧且穩定的半導體元件，非常適合高功率轉換以及測試製程效率的改善。筑波科技與Teradyne ETS產品線合作，提供線性、電源和汽車電子測試，符合客戶需要的大批量量產、質量提升及加快上市時間之半導體測試設備系統、軟/硬整合方案服務。

筑波科技在異質材料界面、Wafer材料分析MA、3DIC故障瑕疵分析FA，已有很好的測試方案經驗，可增強高階封裝(TSV、Flip-Chip等)半導體產業的研發品質與生產效率的提升，本次研討會將從WBG功率IC/module及3DIC測試技術等實務分享。

我們邀請您與筑波科技專業團隊就相關議題和技術交流！歡迎寬能帶半導體及3DIC產業領域的廠商先進主管報名參加。

Time	Topic	Speaker
PM 1:00~1:30	Registration 報到登記	
PM 1:30~1:40	Welcome 致歡迎詞	Richard Hsieh APAC Sales VP, Teradyne Steve Hsu President, ACE
PM 1:40~2:10	Teradyne Eagle System introduction Practice Eagle 系統實務介紹	Eric Syu BD Manager, ACE
PM 2:10~2:40	Past to Present: GaN is Now a True Game Changer	JJ Liao Director of Test Operations, Canada GaN System
PM 2:40~3:10	Brief Advanced 3DIC Package Technical Trend and Solutions 簡述3D 半導體封裝技術趨勢及方案	Dr. Chih Chen MSE. Department Professor, NYCU
PM 3:10~3:40	Tea Break 中場休息&方案展示	
PM 3:40~4:00	Brief Compound Materials Test Solution 化合物半導體異質材料測試方案	Antony Hsu RD Project Engineer, ACE
Workshop Group		
PM 4:00~4:10	A: Eagle System Introduction (Eagle 系統測試展示介紹)	Teradyne/ACE
PM 4:10~4:20	B: EOTPR-3DIC Advanced Package Failure Analysis (FA 展示介紹)	Teraview/ACE
PM 4:20~4:30	C: SiC/GaN Wafer 及材料 MA 展示介紹	ACE
PM 4:30~4:40	D: 半導體整合測試及設備服務介紹	ACE
PM 4:40~5:00	Q&A 會後討論	

活動日期: 2022年6月28日(二) PM1:00 – PM5:00

活動地點: 新竹縣竹北市生醫二路66號 筑波醫電大樓 (新竹生醫園區)

報名方式: 03-5500909 ext. 3407林小姐/ 3502 鄭小姐

service@acesolution.com.tw

線上報名: http://register.acesolution.com.tw/2022_ACE_Teradyne_ETS



掃描 QR Code
直接線上問



手機掃碼報名

TERADYNE TeraView



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.